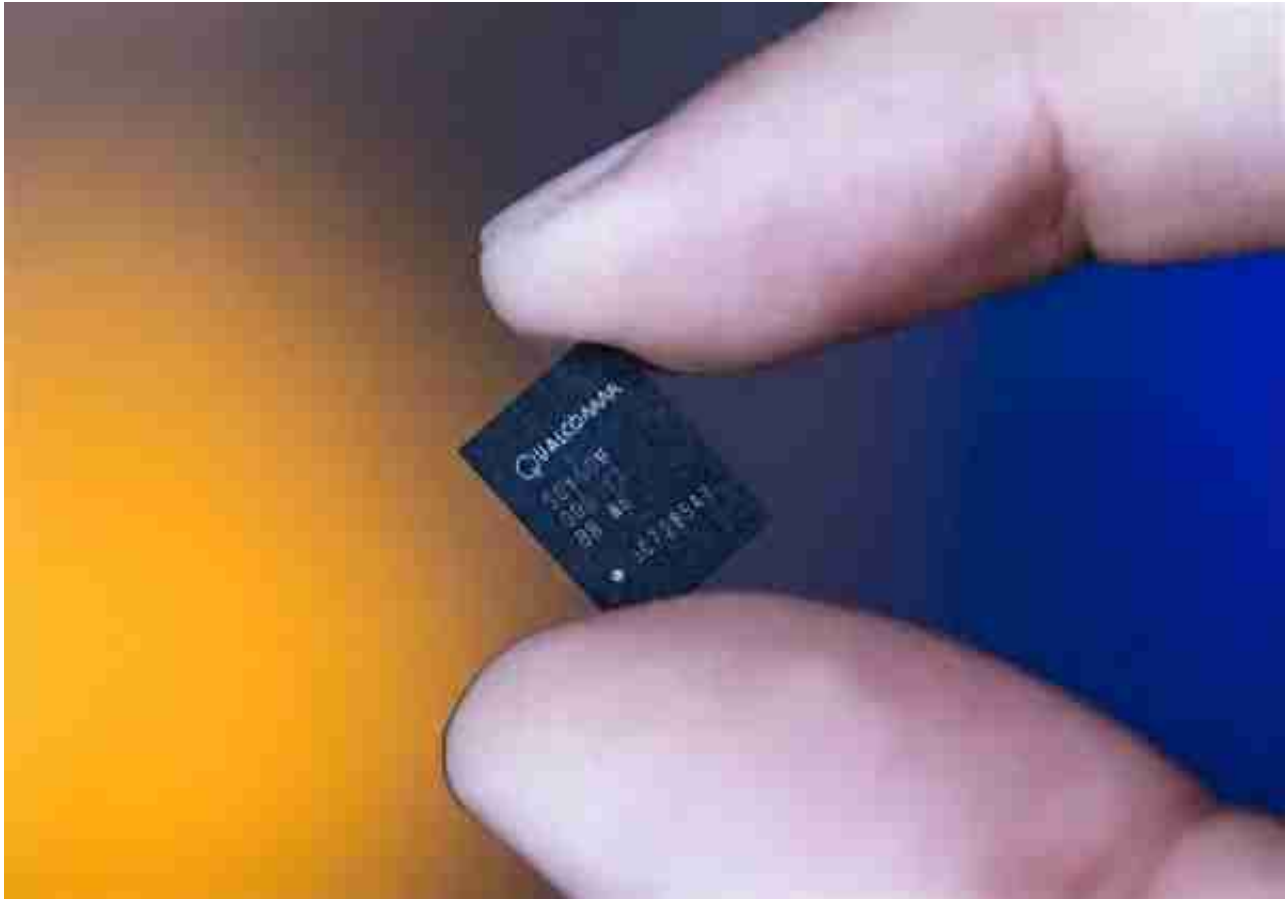


5G网络和各个领域结合起来，几乎都会发生绝妙的化学反应。高通率先将骁龙5G基带芯片和AI套件融合，在二者的双重赋能之下，脱离各行业沿用已久的陈旧模式，通过智能手机、PC、头显、汽车数字底盘等前沿科技设备高度广泛地应用，为人们带来一个更加便捷、高效、安全、舒适的超互联时代。



高通在大力推动5G物联网终端商用快速普及的同时，还为全球用户打造卓越领先的全球性5G基带芯片解决方案。骁龙5G基带芯片在业内声名赫赫，尤其是高通最先进的骁龙X70 5G基带芯片，是目前全球最出色、最全面的5G芯片解决方案。搭载骁龙X70的终端设备轻松实现了全球首个5G毫米波独立组网连接，骁龙X70芯片5G+AI的强强组合，是高通继骁龙X65芯片之后，为5G市场投放的又一“超级大招。”

基于骁龙X70 5G基带芯片，高通和中兴通讯合力完成了全球首个5G毫米波独立组网用例，开创了全球传输速度最快的5G毫米波独立组网新纪元，助力下一代更加强悍的无线光纤的全面部署。在毫米波独立组网情境下，骁龙X70芯片连接性能超过了8Gbps的峰值速度。



骁龙X70 5G基带芯片释放出的极致速度、高智能处理能力、大覆盖范围以及高能效等等卓越特性，赋能5G更加持久的智能网联，令用户深度体验极致5G连接感受。